

产品简介

UF6908 是一种单组份、低卤、高可靠性的环氧底部填充胶, 适用于 CSP (FBGA) 以及 BGA。加热后可快速固化, 抗机械应力出色。低粘度, 常温流动性好, 在常温下即可充分填充 CSP 和 BGA 的底部。

固化前特性

	典型值	范围
外观	黑色液体	
化学类型	环氧树脂	
密度(g/cm ³)	1.16	1.14-1.18
粘度(mPa.s)(Brookfield HB)		
CP40, 20rpm	360	330-400
室温使用期 (天@25°C)	3	

推荐固化条件

130°C固化 8min 或

150°C固化 5min

固化速度的快慢, 取决于加热设备的加热效率和被加热 PCB 板的厚度以及芯片大小。要根据加热设备和被粘接物体适当的调节固化温度和固化时间。

声明: 该说明书真实可靠。其中数据仅可作为参考。对于任何人使用我们无法控制的方法得到的结果, 我们恕不负责。如果客户使用了本说明书未提及的使用方法, 造成的后果应由客户自己负责。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。客户应该对产品是否适用于使用要求负责。烟台长盈公司明确声明对任何必然的或意外损失包括利润方面的损失都不承担责任

烟台长盈电子科技有限公司

地址: 山东.烟台经济技术开发区珠江路 60 号

电话: 0535-6105906 传真: 0535-6105907

固化后材料的特性

(试样在 130°C固化 30min)

物理特性	典型值	测试标准
玻璃转化温度(°C)(TMA)	113	ASTM E1545
热膨胀系数		GB/T 1036-1989
α_1 (ppm/°C)	55	
α_2 (ppm/°C)	171	
硬度(邵氏 D)	80	GB/T 2411-1980
吸水率(%)(24h@25°C)	0.23	GB/T 1034-1998
储能模量@25°C,DMA(N/mm ²)	2610	

电性能

介电常数/介电损耗		GB/T 1693-2007
1GHz	3.19/0.0099	
2GHz	3.24/0.0088	
体积电阻率($\Omega \cdot \text{cm}$)	4.3×10^{16}	
表面电阻率(Ω)	1.3×10^{16}	
介电强度(Kv/mm)	16.5	

声明：该说明书真实可靠。其中数据仅可作为参考。对于任何人使用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。如果客户使用了本说明书未提及的使用方法，造成的后果应由客户自己负责。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。客户应该对产品是否适用于使用要求负责。烟台长盈公司明确声明对任何必然的或意外损失包括利润方面的损失都不承担责任

烟台长盈电子科技有限公司

地址：山东.烟台经济技术开发区珠江路 60 号

电话：0535-6105906 传真：0535-6105907

使用说明

1. 在使用前必须恢复到室温，在恢复到室温以前请不要打开包装。
2. 可在室温下直接填充。如需加快填充速度，须对 PCB 板预热，建议预热温度低于 90℃。
3. 建议采用 “一” 字形或 “L” 形涂胶，在用 “一” 字涂胶时涂胶长度为芯片边长的 80%。涂胶速度为 2.5-12.7mm/s。
4. 未用完的胶，须密封后再放入 -20℃ 冰箱贮存。每个包装的产品可回温使用 2-3 次，不建议多次回温使用。

注意事项

请远离儿童存放。

本品建议在通风良好的场所内使用。

若不慎沾到皮肤上，请马上用肥皂水清洗。

若不慎沾到眼睛上，请先用大量的水清洗，然后就医。

详细内容请参阅本品的 MSDS。

包装规格

55cc /支

贮存条件

在 -20℃ 洁净、干燥处贮存。

贮存期：六个月。

声明：该说明书真实可靠。其中数据仅可作为参考。对于任何人使用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。如果客户使用了本说明书未提及的使用方法，造成的后果应由客户自己负责。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。客户应该对产品是否适用于使用要求负责。烟台长盈公司明确声明对任何必然的或意外损失包括利润方面的损失都不承担责任

烟台长盈电子科技有限公司

地址：山东.烟台经济技术开发区珠江路 60 号

电话：0535-6105906 传真：0535-6105907